

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
9	15.Feb.2005	056722	ADDED LOT NUMBER RE-DRAW		K.INOUE		O.Hashiguchi

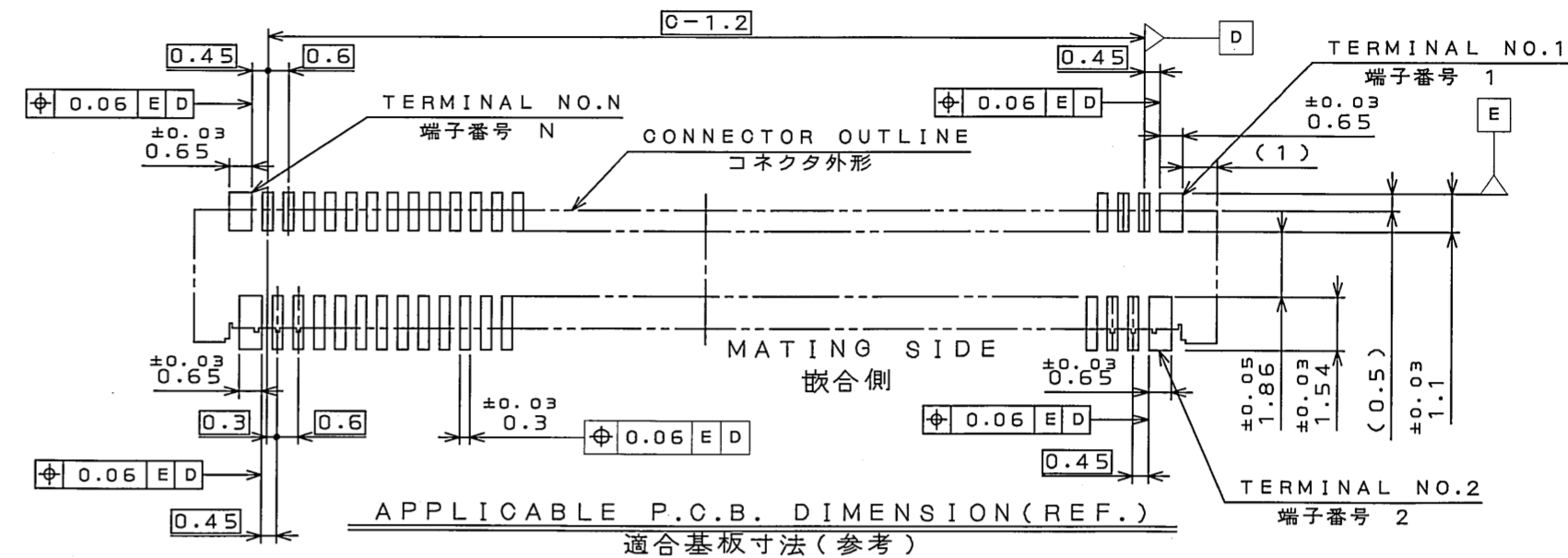
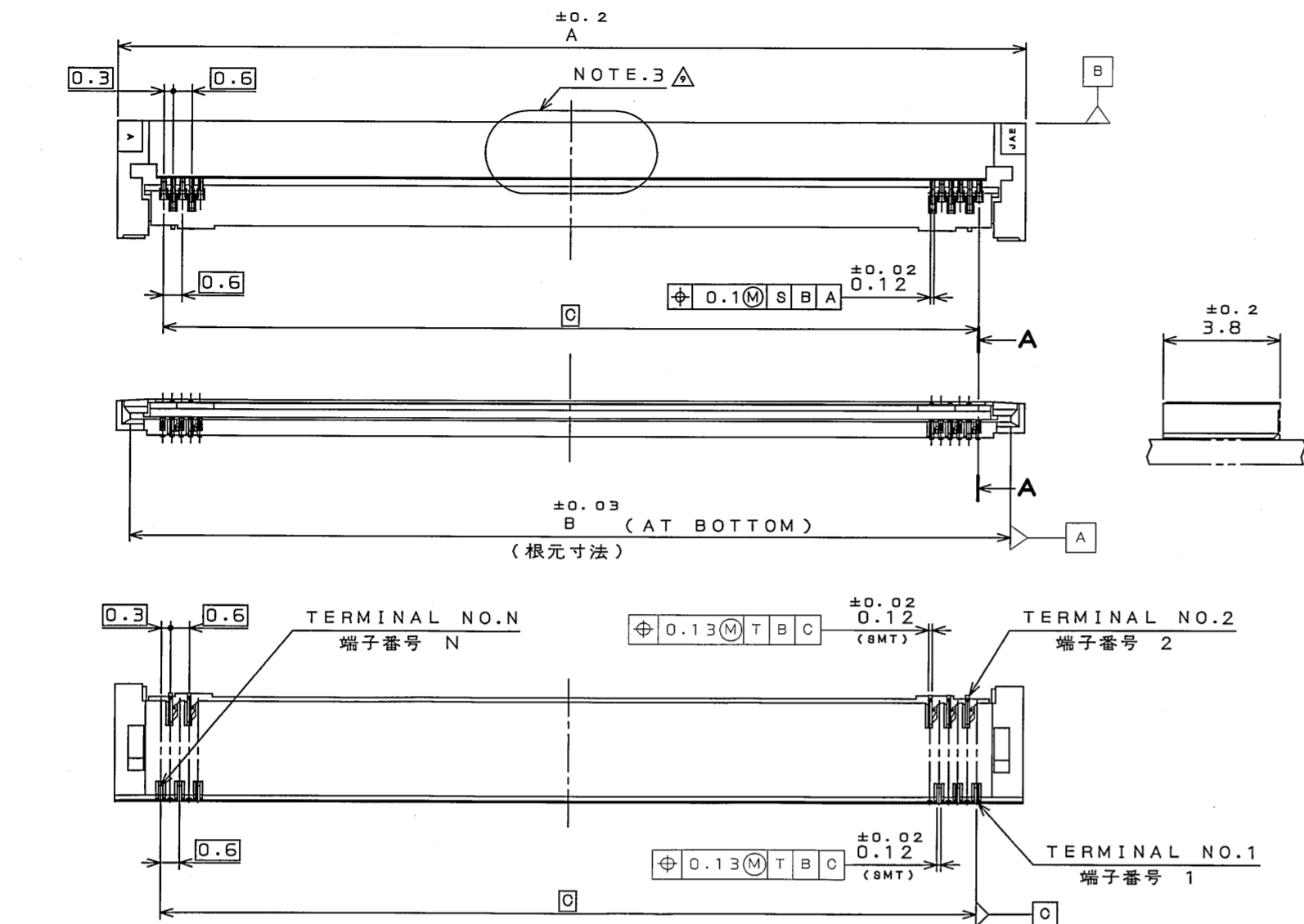
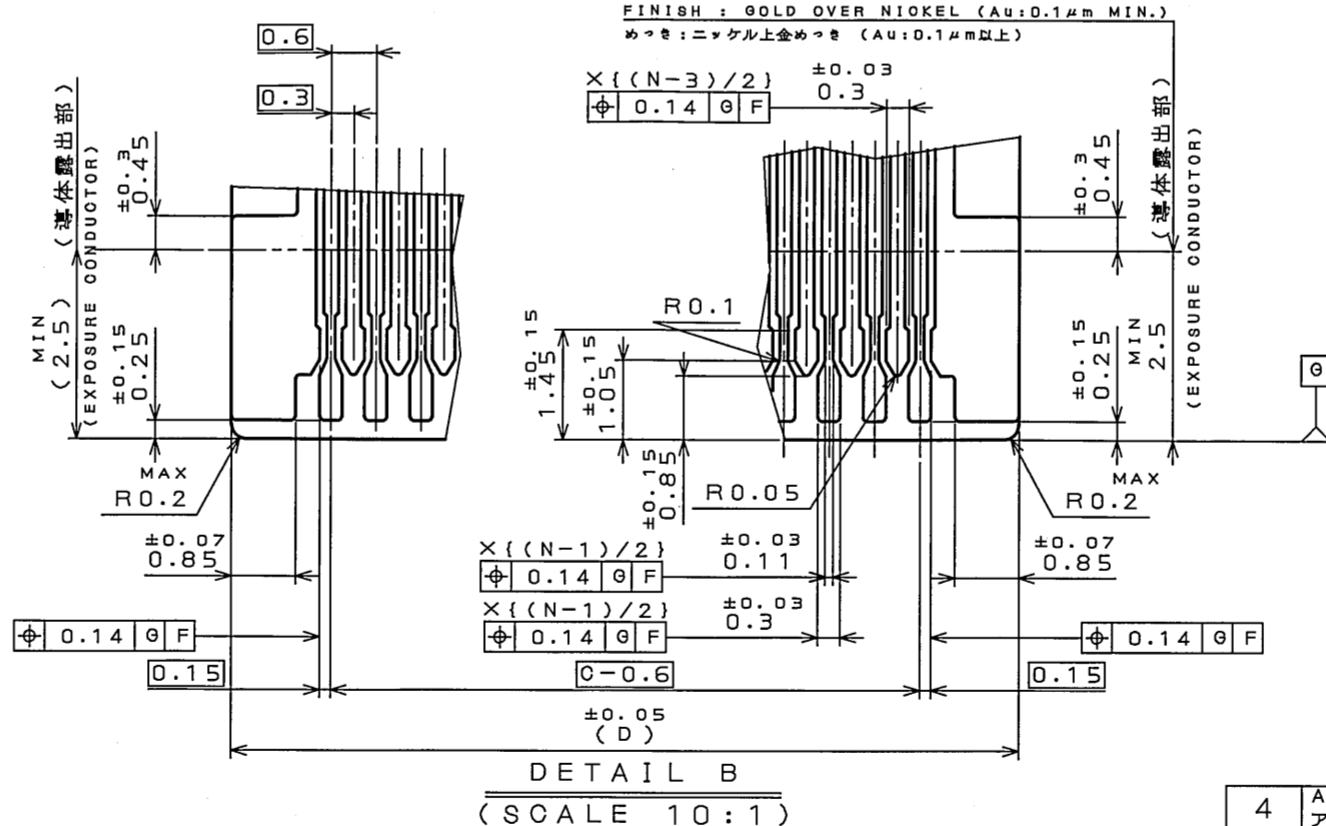
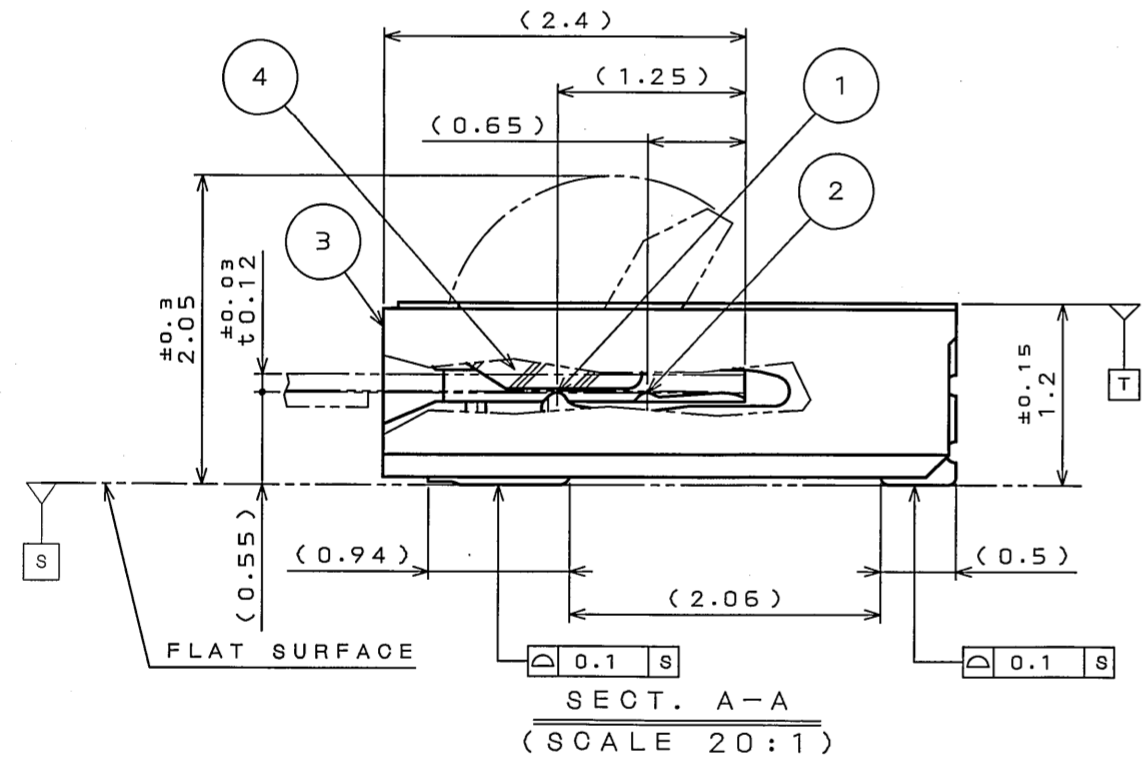
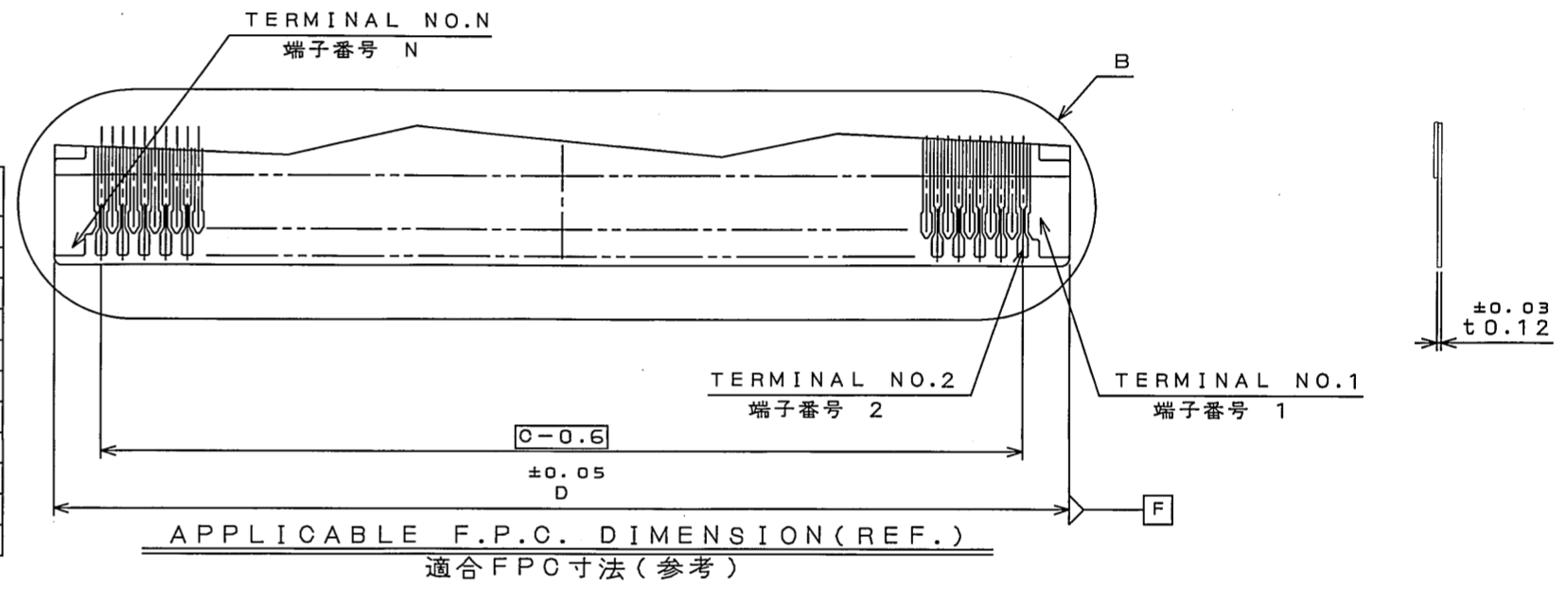


TABLE 1

PRODUCT NO. 品名	A	B	C	D
FF0255881	19.2	18.31	16.2	18.23
FF0251881	18.0	17.11	15.0	17.03
FF0245881	16.2	15.31	13.2	15.23
FF0239881	14.4	13.51	11.4	13.43
FF0235881	13.2	12.31	10.2	12.23
FF0233881	12.6	11.71	9.6	11.63
FF0229881	11.4	10.51	8.4	10.43
FF0227881	10.8	9.91	7.8	9.83
FF0225881	10.2	9.31	7.2	9.23
FF0221881	9.0	8.11	6.0	8.03
FF0215881	7.2	6.31	4.2	6.23



NOTE 1. REFER TO THE DRAWING SJ036196 FOR EVEN NUMBER OF CONTACTS.
NOTE 2. FPC COMPOSITION (RECOMMENDED) REFER TO TABLE 2
NOTE 3. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER PORTION OF THE CONNECTOR.

注1. 偶数芯数のコネクタ寸法は SJ036196 参照。
注2. FPC構成(推奨) TABLE 2 参照。
注3. ロット番号がコネクタ上面中央部に表記される。

DESIGNATION 命名法

FF02 * * SS 1
SERIES シリーズ

CONTACT FINISH
(1: GOLD OVER NICKEL (Au: 0.1μm MIN))
コネクタめっき仕様 (1: ニッケル上金めっき (Au: 0.1μm以上))

MODIFICATION S: NICKEL BARRIER
モディファイ ニッケルバリア

CONNECTOR FORM (S: SOCKET)
コネクタ形状 (S: ソケット)

NO. OF CONTACTS (N) (NOTE 1)
芯数 (N) (注1)

TABLE 2

COMPOSITION 層名	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	THICKNESS (EXAMPLE) 厚さ (例)	NOTE 備考
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.3~0.6 μm	0.1 μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルめっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	3~9 μm	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	18 μm	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	13 μm	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	15 μm	30 μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	12.5 μm	-

4 ACTUATOR アクチュエータ	1 PPS		COLOR: BLACK/色相: 黒 UL94V-0
3 BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1 LCP		COLOR: WHITE/色相: 白 UL94V-0
2 CONTACT 2 コンタクト 2	(N-1) 2 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL (Au: 0.1μm MIN.) ニッケル上金めっき (Au: 0.1μm 以上)
1 CONTACT 1 コンタクト 1	(N+1) 2 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL (Au: 0.1μm MIN.) ニッケル上金めっき (Au: 0.1μm 以上)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL
仕様書 (SPECIFICATION) JAOS-1627 JAH-1627		第1版 (ORIGINAL DATE) 1.Aug.2001	尺 (SCALE) 5:1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	シリーズ (SERIES) FF02
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. K.INOUE	名称 (TITLE) FF02 * * SS 1
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD. O.HASHIGUCHI	図面番号 (DRAWING NO.) SJ036197
		質量 (MASS)	版数 (REV.) 9

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9